

江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），未变更。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 490,998,199 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	捷捷微电	股票代码	300623
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张家铨	方施瑜	
办公地址	江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号	江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号	
传真	0513-83220081	0513-83220081	
电话	0513-83228813	0513-83228813	
电子信箱	zhangjiaquan1188@163.com	hifangshiyu@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的 IDM 业务体系为主。公司集功率半导体器件、功率集成电路、新型元件的芯片研发和制造、器件研发和封测、芯片及器件销售和服务为一体的功率（电力）半导体器件制造商和品牌运营商。公司主营产品为各类电力电子器件和芯片，分别为：晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片（包括：TVS、放电管、ESD、集成放电管、贴片 Y 电容、压敏电阻等）、二极管器件和芯片（包括：整流二极管、快恢复二极管、肖特基二极管等）、厚膜组件、晶体管器件和芯片、MOSFET 器件和芯片、碳化硅器件等。公司所处的是功率半导体分立器件行业，分立器件是电力电子产品的基础之一，也是构成电力电子变化装

置的核心器件之一，主要用于电力电子设备的变频、变相、变压、逆变、整流、稳压、开关、增幅、保护等，具有应用范围广、用量大等特点，在消费电子、汽车电子、电子仪器仪表、工业及自动控制、计算机及周边设备、网络通讯、智能穿戴、智能监控、光伏、物联网等众多国民经济领域均有广泛的应用。

公司通过了IATF16949汽车行业质量体系认证、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO45001职业健康体系认证、QC080000有害物质过程管理体系认证、UL安全认证、SGS环保标准鉴定认证等规定，公司产品应符合UL电气绝缘性要求、RoHS环保要求、REACH化学品注册、评估、许可和限制要求、无卤化等。

一、目前公司主要经营模式：

公司晶闸管系列产品、二极管及防护系列产品采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式，即集功率半导体芯片设计、制造、器件设计、封装、测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体。公司MOSFET主要采用Fables+封测的业务模式，目前，芯片（8英寸）全部为委外流片，部分器件封测代工。

目前，公司具体经营模式如下：

1、采购模式

公司物资管理部负责原材料、辅助生产材料的采购，具体采购程序如下：

（1）根据采购计划对采购产品进行分类

（2）采购信息的编制和确定

物资管理部根据《采购计划单》编制《采购合同》，主要原材料采购文件应包括拟采购产品必要的信息。如有必要，物资采购部应请相关技术、品质管理部参与采购要求和规范的制定，或与供方共同制定采购要求和规范，以便利用供方专业知识使公司获益。

（3）采购的执行

物资管理部根据经批准的《采购合同》，在《合格供方名录》的供方范围内进行采购。采购通常以与供方签订供货合同的方式进行，以明确采购产品的价格、交货期限、技术标准、验收条件、质量要求、违约责任等相关内容；

对于长年供货的供方，物资管理部在以合同的方式向供方明确采购产品的技术标准、验收条件、质量要求、违约责任等相关内容后，可以采用传真购货或口头通知的方式进行具体的采购；物资管理部应及时跟踪采购进度，反馈给相关部门。

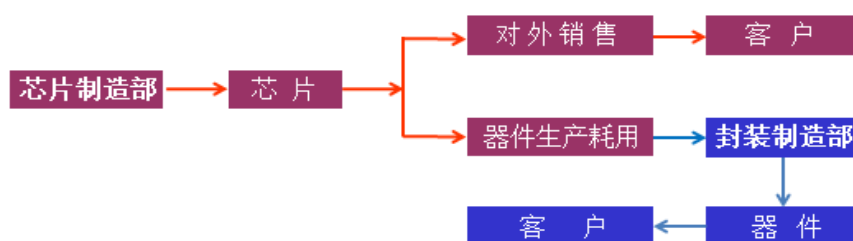
（4）采购产品的验证

物资管理部应协调采购产品的验证活动；当公司或公司客户提出在供方的现场实施验证时，物资管理部应在采购信息中对需要在供应商现场开展验证的安排作出规定；采购产品到达公司后，材料仓库进行登记并存放于待检区，报相关技术、品质管理部进行检验；与供应商签订的技术协议应交品质管理部进行审核，品质管理部负责技术协议文件的管理和发放，确保公司使用的技术协议是现行有效的。

2、生产模式

（1）晶闸管和防护器件

公司根据销售订单要求，制定生产计划，由技术管理部制定工艺卡、作业指导书和检验规程，交给生产人员在生产中参照执行。公司生产部门分为芯片制造部和封装制造部，生产模式如下：



①生产计划和任务单

芯片制造部/封装制造部根据产品要求评审的结果，考虑库存情况，并结合公司的生产能力，制定《生产计划单》；芯片制造部/封装制造部根据《生产计划单》，组织下达《随工单》安排生产；

②动力设备部负责按《设备管理控制程序》的规定做好生产设备的管理、维护和保养工作。

③生产过程控制

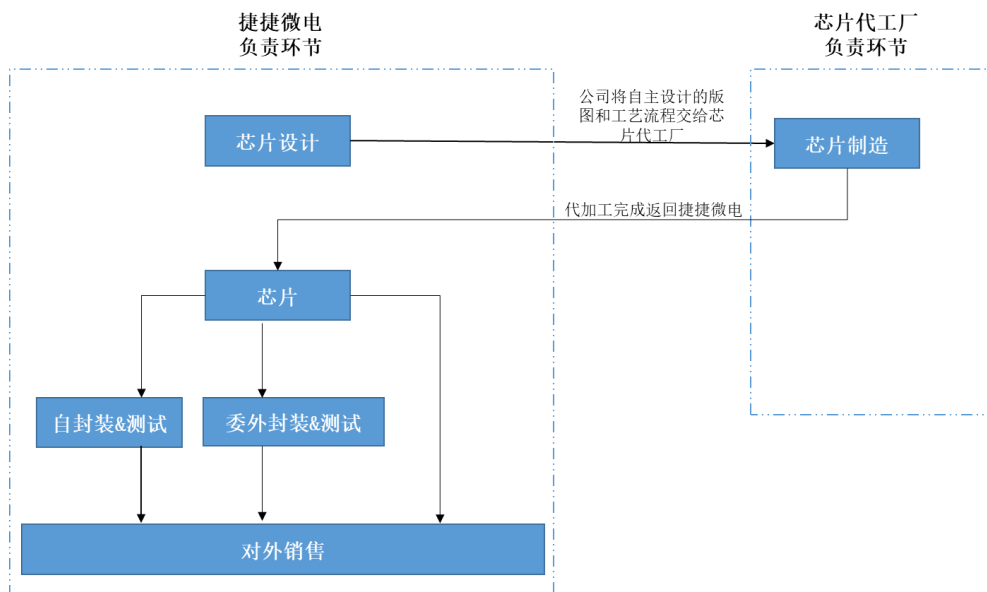
A. 技术管理部负责编制适宜让生产员工清楚理解的工艺卡、作业指导书和检验规程；

B. 芯片制造部/封装制造部组织和监督操作者严格依据文件的要求进行操作，做好自检和互检要求的记录；

C. 品质管理部根据《产品的监视和测量控制程序》的要求进行产品检验，按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》的要求对异常现场进行整改和预防。

(2) MOSFET

公司MOSFET主要采用Fabless+封测的业务模式。公司委托芯片代工厂进行芯片制造，由于产能紧张，芯片一部分用于公司自主封装，另一部分委托外部封测厂进行封测。除芯片制造由代工厂代工生产外，公司MOSFET产品与晶闸管和防护器件产品生产模式一致。



3、研发模式

公司主要采用自主研发模式，公司设有工程技术研究中心，主导新技术、新产品的研究和开发。为提高研发人员的积极性，公司建立了鼓励发明创造奖励制度。该奖励制度不仅提高了研发人员的工作积极性，还可以激励全体员工参与技术革新活动，取得了较为明显的成效。

公司研发活动按照以下流程开展：

(1) 项目来源

公司研发项目主要来源于以下三个方面：一是工程技术研究中心基于对行业发展趋势的深入调研并结合公司发展战略和发展目标，选择新技术、新工艺、新产品进行研发；二是公司销售部通过对市场需求进行综合调研后，对前景广阔且市场需求大的新产品、新技术、新工艺提出立项申请；三是来源于客户定制化产品的研发需求。

(2) 项目立项

工程技术研究中心接到新产品需求信息后对产品需求信息进行初步论证，如初步论证可行，则召开项目立项会议，确定项目研发内容和项目负责人并组建项目组，正式启动项目研发工作。

(3) 设计和开发

项目组根据设计和开发的相关要求，开展设计和开发工作。设计和开发完成后，将召开评审会议，对项目是否已经完成设计和开发工作并取得相应的研发成果予以评定。

(4) 反馈和纠正

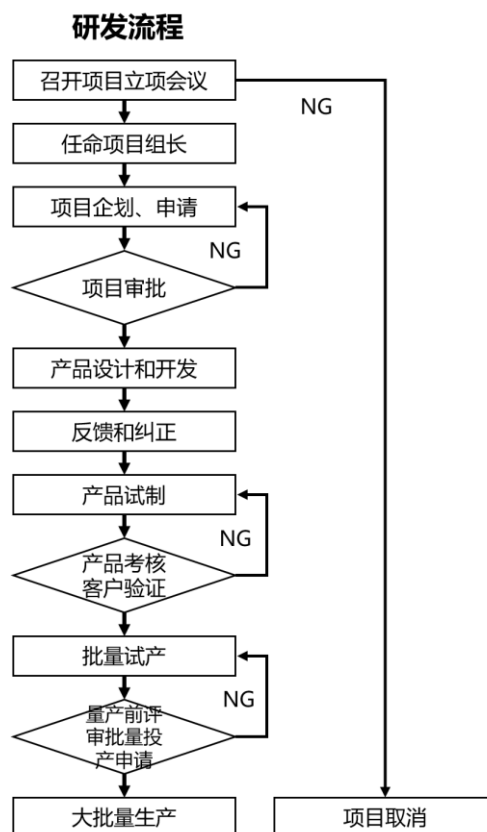
项目组根据会议评审结果，对项目设计和开发方案予以进一步完善，并将修改和完善的内容及时反馈给工程技术研究中心主任。

(5) 产品试制

项目组在品质、生产等相关部门的配合下，依据评审确定的设计和开发方案进行打样，样品质量及性能由品质部负责检验和认定。如样品经检验并经客户验证合格，则召开项目评审会，对样品的性能参数予以全面评估，如评估认定样品的性能参数通过项目验收，则进入批量试生产阶段。

(6) 小批量试生产

产品试制通过后，进入小批量试生产环节。项目组指定具体研发人员全程跟踪小批量试生产的作业状况和产品品质，如小批量试生产产品符合相关要求，项目组提交批量投产申请，批量投产申请获得批准后，项目组将设计和开发成果移交生产部门进行大批量生产，项目研发工作结束。



4、销售模式

(1) 营销理念

公司的营销理念为：建立售前、售中、售后一体的市场营销团队，发展知名品牌客户和优质渠道商，与客户形成战略性合作，树立公司国际品牌形象，提高市场占有率。

(2) 营销方式

公司产品应用的市场领域较多，产品规格多，且对产品性能要求各异。公司既销售公司通用规格的产品，也可以根据客户的诉求为其设计、生产定制化产品，并可对客户的全方位的技术服务。具体销售流程如下：

A. 公司销售人员与客户进行初步沟通，了解客户的产品用途、需求、用量、付款条件等信息，及已有产品不足之处或预期产品需要达到的最佳效果，为客户提供选型服务或建议，与客户建立初步合作关系；

B. 如客户有特殊要求，销售人员应与应用工程师或其他部门工程师共同评估公司产品是否满足客户的要求，并选择合适的产品型号；

C. 销售人员和区域销售经理评估客户信誉状况，选择合作模式，后续按照此模式逐步推进合作；

D. 销售人员提供给客户相应产品的规格书，向客户介绍公司产品特点、性能指标，帮助客户认识、了解公司的产品及性能，并听取客户进一步的意见；

E. 根据进度安排，销售人员准备好选型的样品提供给客户，及时跟进客户的试验情况，与客户沟通解决试验中遇到的问题，最终达到客户要求的理想效果；

F. 针对有特殊要求的客户，如其用量较大或其应用具有领域代表性，公司可为其设计、生产定制化产品，定制化产品销售流程如下：

a. 销售人员了解客户的产品特殊要求、产品应用领域、时间进度表、需求量、目标价格、付款条件等信息，填写《定制产品需求单》，交由区域经理或市场营销部正/副部长审核评估；

b. 市场营销部将《定制产品需求单》送交相关技术部门和品质管理部，品质管理部组织各部门对定制产品的市场潜力、产品性能以及公司的生产能力、物料物资、资金情况等进行评估，将评估结果向总经理汇报，由总经理作出最终批示；

c. 根据总经理同意生产定制产品的批示，市场营销部与客户签订定制产品加工合同；各部门按照分工开始生产样品，样品完成后，由相关技术部门完成产品的考核和试验；

d. 样品达到预期的性能指标后将该样品的试验结果和样品提供给客户进行产品试验，及时跟进客户的

试验情况，改善产品性能并重新送样，最终满足客户要求的理想效果；

e. 根据客户定制产品的试验、生产情况，公司各部门对定制产品进行总结，确定是否将定制产品纳入公司标准产品的量产计划中。

5、盈利模式

功率半导体芯片的设计制造能力是公司的核心竞争力，是公司可持续盈利及发展的基础。公司多项功率半导体芯片和封装器件的先进技术不仅保证公司生产工艺领先、标准产品质量可靠，还能够按照客户提出的个性化需求设计、调整功率半导体芯片和封装器件的生产工艺，生产定制产品，及时满足终端产品在电能转换与控制、保护高端电子产品昂贵电路等方面的技术升级。同时，公司参与到客户的生产经营中，通过分析整理客户在产品结构调整、品质提升过程中的技术瓶颈，有针对性地研发新技术，改进生产工艺，并根据下游行业的发展趋势调整自身产品结构，经公司技术、市场、生产、财务、管理各部门共同严格论证后，将确定未来有广泛市场需求的定制产品转化为公司常规产品生产，最大程度地确保公司产品响应客户和行业发展的需要。

公司为客户定制产品不仅体现了公司研发创新的技术实力，也表现出公司与客户实现双赢的市场营销能力，因此，公司产品深受下游客户认可，品牌知名度和美誉度不断提升，客户结构正向大型化、国际化方向发展，同时，产品市场结构不断延伸，在保持传统家电市场、工业类市场优势地位的同时，正逐步进入航天、汽车电子、IT产品等新兴市场。

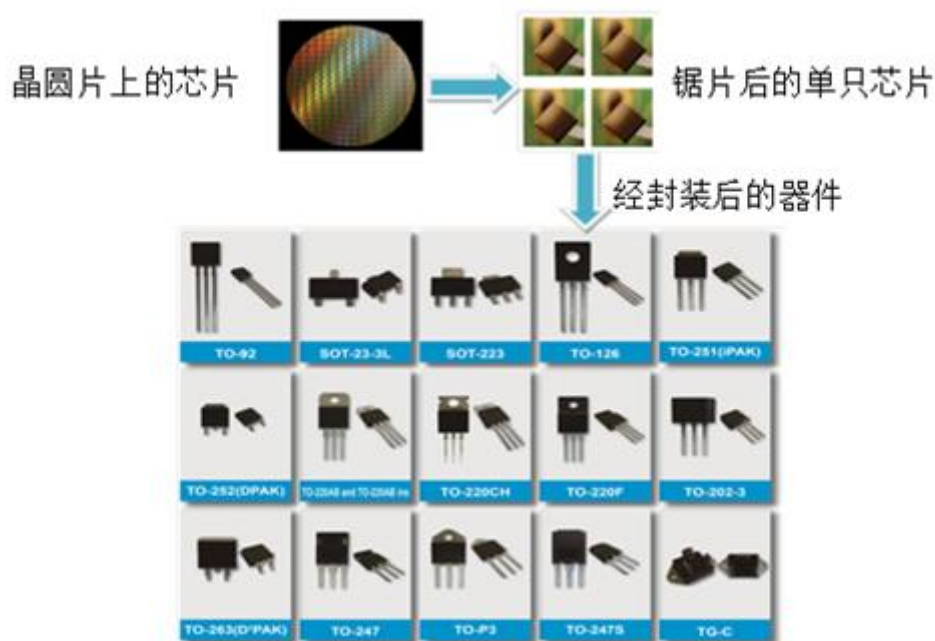
6、管理模式

在长期经营发展中，公司建立了符合公司自身经营特点和发展方式的管理模式，设置合理的职能部门，在公司董事会制定的经营路线下，坚持公开、透明地执行各项公司制度和计划，协调各部门之间有效配合，形成了较高的管理效率。

半导体行业是技术密集型行业，公司重视研发管理，根据公司现有和未来产品系列分别设立研发项目组，有针对性地研发新产品和新技术，最大程度地保证公司的研发效率和研发成果转化率，不断提高市场竞争力和盈利能力。同时，公司不断吸收引进先进人才，通过激励措施和实践培养，为公司未来发展储备技术、营销、采购等方面的管理人才。

二、公司主要产品系列及用途：

从产品构造划分，公司主要产品是功率半导体芯片和封装器件。功率半导体芯片是决定功率半导体分立器件性能的核心，在经过后道工序封装后，成为功率半导体分立器件成品。



1、晶闸管系列：

晶闸管（又称：可控硅）耐压高、电流大，主要用于电力变换与控制，可以用微小的信号功率对大功率的电流进行控制和变换，具有体积小、重量轻、耐压高、容量大、效率高、控制灵敏、使用寿命长等优点。晶闸管的功用不仅是整流，还可以用作无触点开关以快速接通或切断电流，实现将直流电变成交流电的逆变，将一种频率的交流电变成另一种频率的交流电等作用。晶闸管的出现，使半导体技术从弱电领域

进入了强电领域，成为工业、交通运输、军事科研以至商业、民用电器等方面广泛采用的电子元器件。

2、防护器件系列：

半导体防护器件种类较多，主要有半导体放电管（TSS）、瞬态抑制二极管（TVS）、静电防护元、器件（ESD）、集成防护器件、Y电容、压敏电阻等，可应用于仪器仪表、工业控制、汽车电子、手持终端设备、户外安防、电脑主机等各类需要防浪涌冲击、防静电的电子产品内部，保护内部昂贵的电子电路。由于使用场合广泛，市场需求量较大，半导体防护器件市场规模较为稳定。

3、二极管系列：

二极管是最常用的电子器件之一，二极管的单向导电特性可以把正弦波的交流电转变为脉动的直流电。用途广泛，几乎所有的电路中都有使用到。公司二极管芯片采用SIPOS+GPP钝化工艺，具有高可靠性，三种金属组合供客户选择，主要产品有高耐压整流二极管、快恢复二极管、肖特基二极管、整流二极管模块组件等，用于民用电源整流、工业设备电源整流、漏电断路器、电表、通讯电源、变频器等应用领域。

4、MOSFET系列：

MOSFET，金属-氧化物半导体场效应晶体管，一种全控制型半导体功率分立器件，通过栅极电压的变化来控制输出电流的大小，并实现开通和关断，输入阻抗大、导通电阻小、功耗低、漏电小、工作频率高，工艺基本成熟，是市场规模最大的功率分立器件。应用极其广泛，主要包括电源类和驱动控制类两大类应用。公司MOSFET系列产品主要包括中低压沟槽MOSFET产品、中低压分离栅MOSFET产品、中高压平面VDMOS产品以及超结MOS等产品，广泛用于消费电子、通信、工业控制、汽车电子等领域。

5、厚模组件：

厚模组件系列产品采用，模块集成封装，把可控硅、二极管、MOSFET、IGBT、FRD等芯片组合成不同的电路拓扑结构；在模块基础上集成控制线路，衍生出了固态继电器、智能模块及IPM等功能模块，主要用于调温系统、调光系统、调速等系统；具体应用于软启动、变频器、无功补偿领域。

6、碳化硅器件：

碳化硅肖特基二极管是碳化硅器件之一，具有超快的开关速度，超低的开关损耗，正向压降(Vf)为温度特性，易于并联，可承受更高耐压和更大的浪涌电流，用于电动汽车、消费类电子、新能源、轨道交通等领域，主要产品为塑封碳化硅肖特基二极管器件。

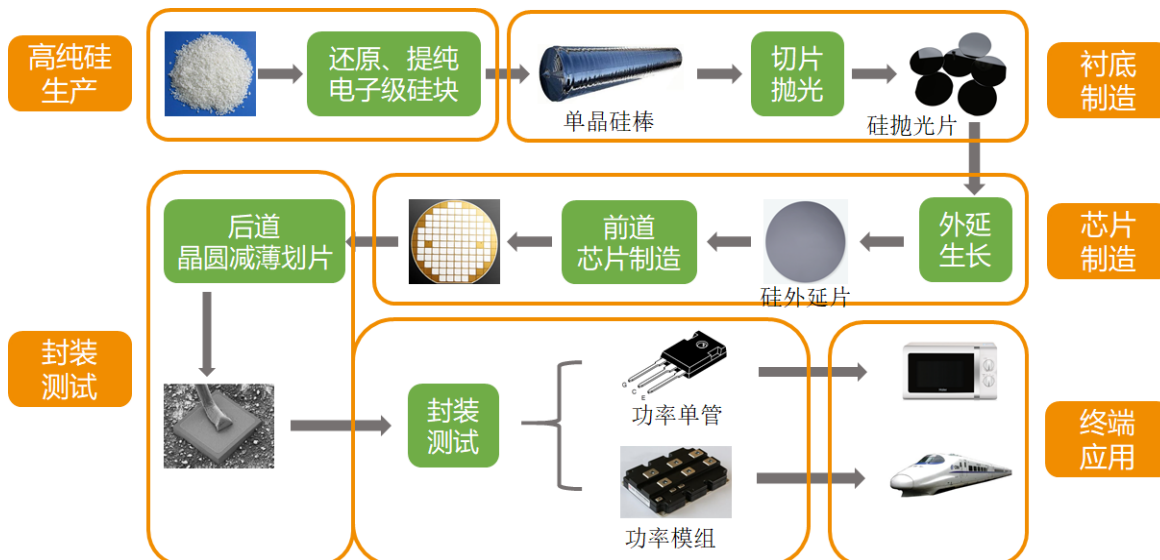
7、电子专用材料：

硅片金刚线切割液、硅片表面加工添加剂、硅片刻蚀抛光添加剂及CMP抛光液等电子专用材料。其中，硅片金刚线切割液应用于硅片的金刚线切片生产，硅片表面加工添加剂应用于硅片表面金字塔绒面结构的腐蚀加工，硅片刻蚀抛光添加剂应用于硅片表面碱腐蚀抛光加工，CMP抛光液用于半导体硅片表面的全局平坦化精密研磨抛光加工（目前正处于研发阶段）。

8、其他：

功率型开关晶体管及达林顿晶体管，应用于点火器、磁电机等领域，具有良好的可靠性和质量。

功率分立器件：从石英砂到终端产品：



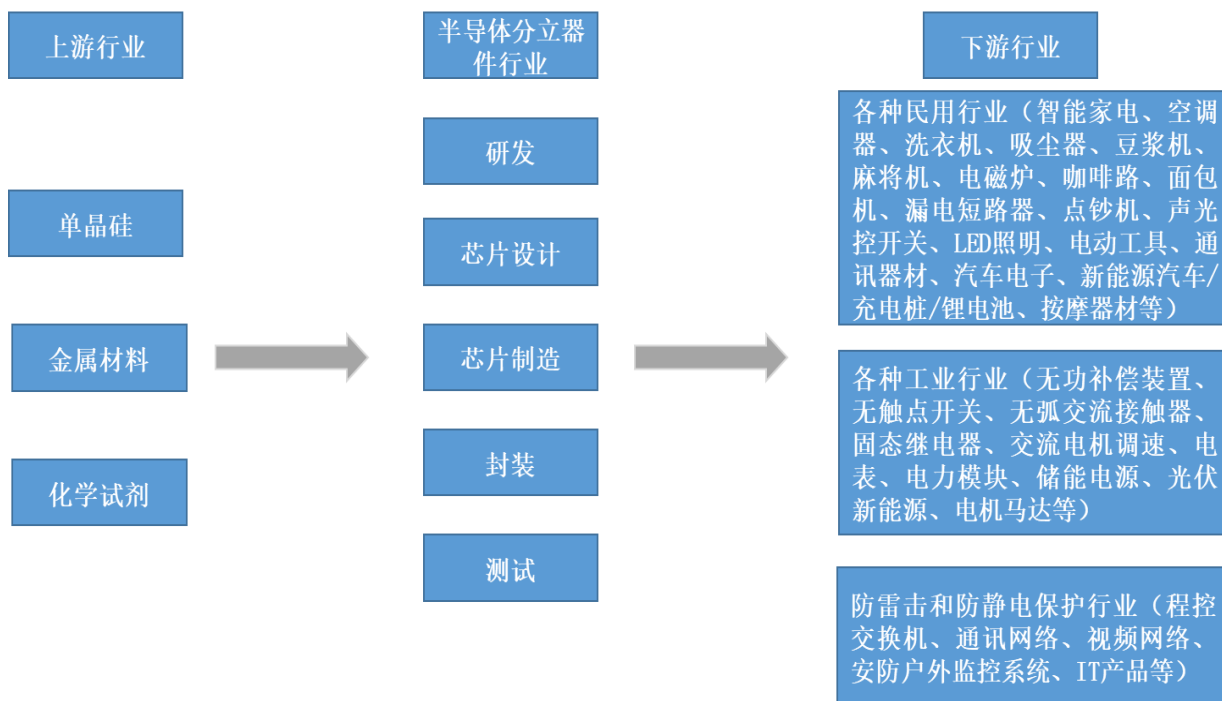
公司主要产品类别图示：



三、上下游行业及发展情况

1、与上下游行业间的关系：

公司所处半导体分立器件制造业的上游行业主要为单晶硅、金属材料、化学试剂行业，下游行业主要为家用电器、漏电断路器等民用领域，无功补偿装置、电力模块等工业领域，及通讯网络、IT产品等的防雷击和防静电保护领域。由于电力电子技术的广泛渗透性，在绝大多数的用电场合，都可能应用电力电子技术进行电能控制和优化。



2、上下游行业的发展情况

①上游行业

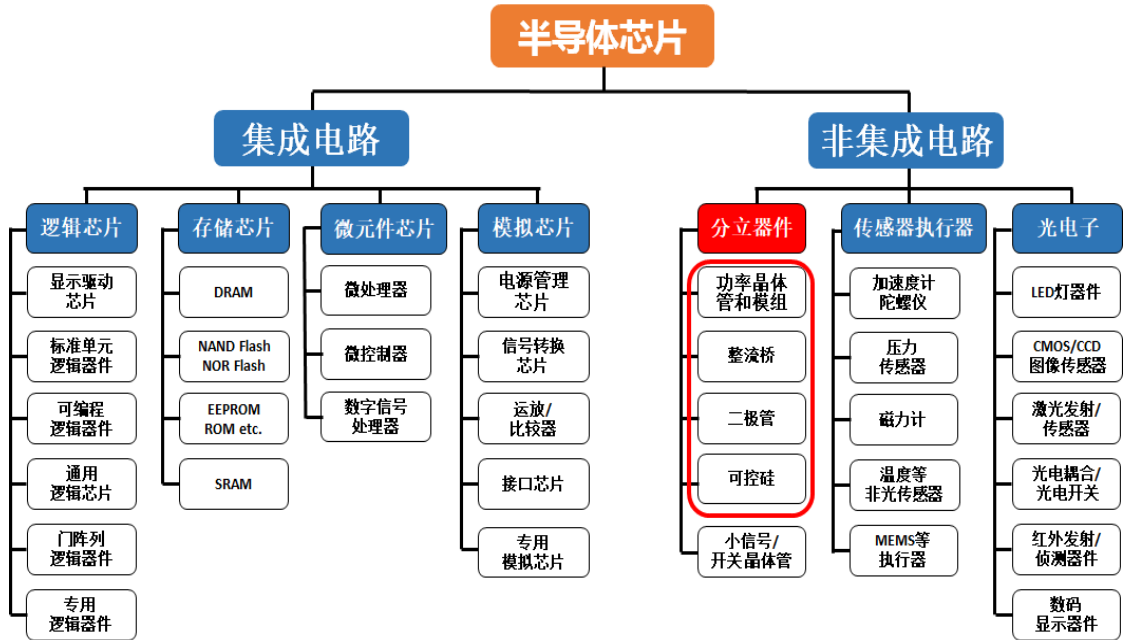
上游行业单晶硅的价格对半导体分立器件制造行业的生产成本有直接影响。目前单晶硅片市场趋于饱和，供需基本平衡；引线框架等金属材料和硼源等化学试剂的市场供应充足，价格比较稳定。

②下游行业

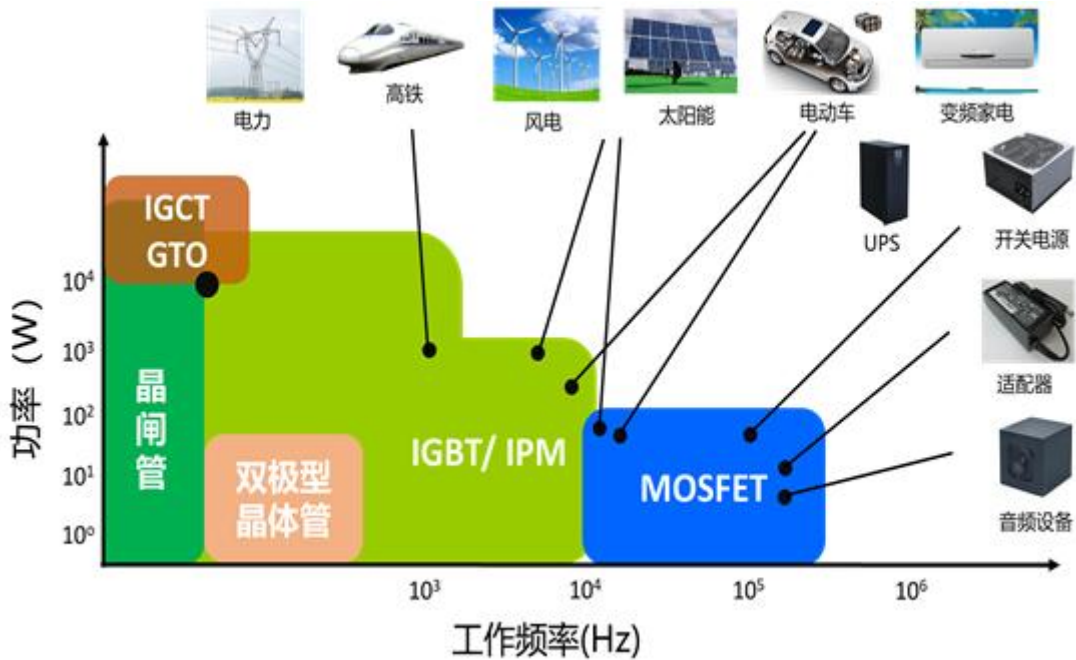
功率半导体分立器件的下游行业分布面极为广阔，终端产品的更新换代及科技进步引导的新产品面世，

都为功率半导体分立器件带来不断增长的市场空间。功率半导体分立器件是连接弱电和强电的桥梁，无处不在，为了合理高效地利用电能，现在发达国家电能的75%需要经过功率半导体分立器件变换或控制后使用。目前我国经过变换或控制后使用的电能仅占30%，70%电能仍采用传统的传输方式，远远达不到应用电力电子技术才能实现的效果。随着我国在民用和工业各个领域对能源节约政策的深入落实，新技术、新工艺、新产品将陆续被研发和推广应用，满足市场需求的扩展和转变。

半导体芯片的分类：2个大类，7个小类：



半导体各功率分立器件的特性及其应用：



资料来源：Yole，中银证券

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	1,010,900,921.04	673,997,139.35	49.99%	537,470,873.08
归属于上市公司股东的净利润	283,486,201.59	189,686,002.12	49.45%	165,668,690.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	248,127,602.67	182,561,463.81	35.91%	152,690,859.49
经营活动产生的现金流量净额	229,112,799.21	199,399,905.99	14.90%	261,393,334.61
基本每股收益（元/股）	0.58	0.44	31.82%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.44	31.82%	0.39
加权平均净资产收益率	12.00%	13.32%	-1.32%	12.86%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	2,940,932,225.59	2,455,151,023.78	19.79%	1,560,565,948.20
归属于上市公司股东的净资产	2,487,905,136.17	2,245,937,201.96	10.77%	1,350,276,466.45

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	153,869,465.95	253,640,873.12	283,688,781.86	319,701,800.11
归属于上市公司股东的净利润	41,817,982.84	74,919,873.95	76,958,129.30	89,790,215.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,944,899.94	72,832,820.04	72,828,732.73	62,521,149.96
经营活动产生的现金流量净额	21,260,070.41	66,202,604.64	55,900,728.28	85,749,395.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	68,656	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	72,592	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
江苏捷捷投	境内非国	27.86%	136,800,000	0			

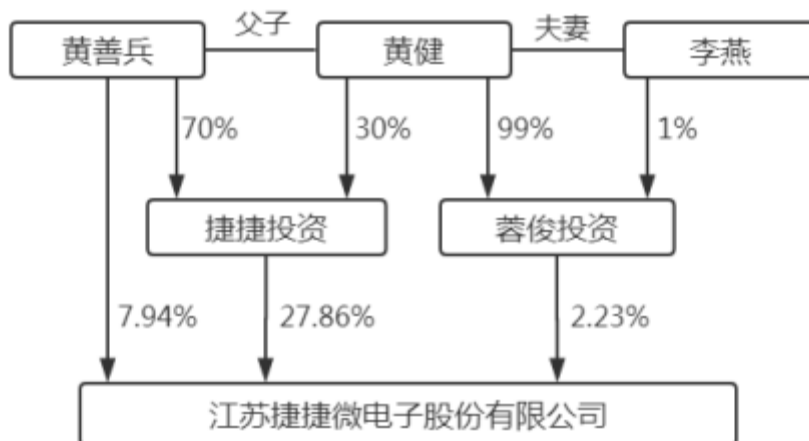
资有限公司	有法人					
黄善兵	境内自然人	7.94%	38,976,000	32,832,000		
南通中创投资管理有限公司	境内非国有法人	6.32%	31,008,000	0		
北信瑞丰资管-非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享01款-上海北信民生凤凰14号单一资产管理计划	其他	4.68%	22,965,059	22,965,059		
王成森	境内自然人	3.46%	17,010,000	16,416,000		
张祖蕾	境内自然人	2.84%	13,926,672	10,445,003		
周雪钦	境内自然人	2.32%	11,406,987	11,406,987	质押	6,406,987
江苏惠泉毅达战新创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.31%	11,331,443	11,331,443		
南通蓉俊投资管理有限公司	境内非国有法人	2.23%	10,944,000	0		
沈欣欣	境内自然人	2.16%	10,600,000	10,260,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏捷捷投资有限公司、南通蓉俊投资管理有限公司与黄善兵为一致行动人，南通中创投资管理有限公司与张祖蕾为一致行动人。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，在全体员工的共同努力下，坚持以市场为导向，坚持创新驱动，坚持国产替代进口，坚决贯彻公司发展战略要求，积极推动重点项目的建设，加速推进重点工作的开展，坚定不移地在功率半导体器件领域内可持续发展，公司的核心竞争力显著提升，细分行业领先地位进一步巩固，主营业务实现了较快增长。

公司在中美贸易战及中国半导体产业亟需国产替代进口和提升国产化率的机遇与挑战下，公司快速启动并实施定增项目布局MOSFET、IGBT及第三代半导体器件等广阔市场新领域。公司围绕主营业务，以内生增长为主，通过募投项目和定增项目的建设，存量与增量并存，并结合公司一以贯之的定制化生产和个性化服务等实现国产替代进口，提升市场份额与品牌影响力，深耕于功率半导体领域，做优做强，保持企业健康、稳定、可持续发展。

报告期内，公司实现营业总收入101,090.09万元，较上年增长了49.99%，归属于上市公司股东的净利润为28,348.62万元，较上年增长了49.45%。

截至2020年12月31日，公司资产总额294,093.22万元，比年初增加48578.12万元，增长19.79%，归属于上市公司股东的净资产248,790.51万元，比年初增加24,196.79万元，增长10.77%。

2020年度，公司重点工作的执行情况概述如下：

1、再融资方面

(1) 2019年9月6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。2019年11月28日，公司取得中国证监会出具的证监许可[2019]2289号核准批复。经中国证监会核准，非公开发行A股股票35,660,997股。本次非公开发行股票于2020年1月8日上市。本次非公开发行股票事项完成后，公司股份总数由269,588,340股变更为305,249,337股。

(2) 2020年11月06日召开了2020年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，同时于2020年12月1日收到深圳证券交易所（下称“深交所”）出具的《关

于受理江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审（2020）745号）。2021年2月23日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2021年第12次上市委员会审议会议（以下简称“上市委会议”），对江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据上市委会议审核结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2、项目建设方面

募投项目	建设内容	主要产品	进展情况
电力电子器件生产线建设项目	新建电力电子芯片生产线1条，年产出6英寸芯片60万片；封装生产线5条（T0-220系列、TP-3P系列、SOT-223、89系列、T0-252系列、T0-92系列），年产出自封电力电子器件30亿只；技术研发及检测线1条；实验室1个。	MOSFET、IGBT、快恢复二极管（FRD）、晶闸管等	截至2020年12月31日，“电力电子器件生产线建设项目”实际投资金额为47,146.92万元，投资进度为88.79%，尚未建设完成，预计于2021年底建成投产。
新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目	新建电子元器件芯片生产线1条，配套成品封装线1条。年产出Φ4英寸圆片150万片，器件20.9亿只，其中贴片压敏电阻1.6亿只，贴片式二极管17.5亿只，交直流光耦1.8亿只。	贴片式压敏电阻、贴片式二极管和交、直流光耦混合电路	截至2020年12月31日，实际投资金额为6,204.70万元，投资进度为32.64%，尚未建设完成，预计于2021年底建成投产。
功率半导体“车规级”封测产业化项目	年封装测试各类车规级大功率器件和电源器件1,627.5kk的生产能力。其中，DFN系列产品1,425kk，TOLL系列产品90kk，LFPACK系列产品67.5kk，WCSP电源器件产品45kk。	“车规级”封测的MOSFET产品（车规级大功率器件DFN系列、车规级大功率器件TOLL系列、车规级大功率器件LFPACK系列、WCSP电源器件）	公司已取得募投项目用地红线图、宗地图和竖向高程界限图等，正在办理“规划条件意见书”等手续。2021年1月26日，公司已完成环评手续。

3、员工激励方面

（1）2020年4月15日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2020年5月7日，公司已为本次符合解除限售条件的88名激励对象办理完成解除限售的事宜，合计解除限售894,102股限制性股票。2020年度，公司2017年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2020年11月6日完成。

（2）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效的将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提高公司经营管理水平，促进公司业绩的平稳、快速提升，确保公司长期发展目标顺利实现，公司推出2020年股权激励计划。2020年9月30日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于〈江苏捷捷微电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等相关议案，同意向215名激励对象授予第一类限制性股票。该事项经2020年第六次临时股东大会审议通过后，已于2020年12月11日办理完成。

4、利润分配方面，2020年5月8日，公司2019年年度股东大会审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年度利润分配预案》，以公司总股本305,249,337股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)，合计派发现金股利人民币61,049,867.40元(含税)，同时向全体股东以资本公积每10股转增6股，分配完成后公司股本总额增至488,398,939股。

5、重大投资方面

(1) 2020年3月30日, 公司召开第三届董事会第二十六次会议, 审议通过了《关于对外投资的议案》, 同意与创业团队(陈亚菊、郭熹、崔小亮)共同出资设立江苏捷捷半导体新材料有限公司。其中, 捷捷微电出资人民币3,600万元, 占捷捷新材料注册资本的60%; 陈亚菊出资1,440万元, 占捷捷新材料注册资本的24%; 郭熹出资720万元, 占捷捷新材料注册资本的12%; 崔小亮出资240万元, 占捷捷新材料注册资本的4%。

(2) 2020年6月24日, 公司召开第三届董事会第三十次会议, 审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》, 同意以自有资金在江苏省无锡市新吴区设立全资子公司。

(3) 2020年8月27日, 公司召开第三届董事会第三十二次会议, 审议通过了《关于公司拟在南通苏锡通科技产业园建设“高端功率半导体产业化建设项目”的议案》、《关于拟设立全资子公司的议案》, 同意公司在江苏南通苏锡通科技产业园区设立全资子公司建设“高端功率半导体产业化建设项目”, 总投资: 25亿元人民币; 资金来源: 公司自筹; 经营范围: 主要从事高端功率半导体产业化建设项目的研发、生产及销售; 项目总规划用地194亩。同时, 为了进一步优化产业链, 完善公司战略布局, 强化竞争优势, 进一步增厚国产功率半导体器件进口替代空间, 进一步添加企业活力, 提高公司核心竞争力。根据公司的战略规划和经营发展需要, 公司以自有资金在南通苏锡通科技产业园设立全资子公司, 注册资本: 2亿元人民币。

(4) 2020年9月30日, 公司召开第四届董事会第二次会议, 审议通过了《关于拟在南通中创区设立分公司调整为全资子公司》的议案, 同意公司以自有资金1亿元人民币在南通中创区设立全资子公司, 公司出资比例为100%。

6、科研方面, 公司历来十分重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高, 报告期内, 公司把握市场趋势, 各项产品研发项目均有有条不紊的进行。截至2020年12月31日, 公司获得授权专利108件, 其中: 发明专利19项, 实用新型专利88项, 外观专利1项。已受理发明专利71项, 受理实用新型专利16项。其中: 捷捷微电子截至12月底获得授权专利39项, 其中发明专利12项、实用新型专利27项。申请受理专利共计26件, 其中: 发明专利19件, 实用新型专利7项; 捷捷半导体截至12月底获得授权专利61项, 其中发明专利7项、实用新型专利53项、外观专利1项。申请受理专利共计43件, 其中: 发明专利38件, 实用新型专利5项; 捷捷上海截至12月底获得授权专利8项, 其中实用新型专利8项。申请受理专利共计14件, 其中: 发明专利12件, 实用新型专利2项; 捷捷无锡截至12月底申请受理专利共计4件, 其中: 发明专利2件, 实用新型专利2项。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位: 元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
功率半导体芯片	283,647,776.49	107,334,521.58	37.84%	82.54%	88.88%	1.27%
功率半导体器件	711,023,331.98	356,357,016.23	50.12%	41.21%	50.50%	3.10%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、22。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债453,326.57元、其他流动负债45,526.59元、预收款项-498,853.16元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为0.00元；对少数股东权益的影响金额为0.00元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债386,034.52元、其他流动负债36,778.62元、预收款项-422,813.14元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为0.00元。

上述会计政策变更分别经本公司于2020年8月17日召开的第三届董事会第三十一次会议批准。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、2020年3月31日，江苏捷捷微电子股份有限公司与陈亚菊、郭熹、崔小亮共同出资人民币6,000万成立控股子公司“江苏捷捷半导体新材料有限公司”。其中，捷捷微电出资3,600万元，占捷捷新材料注册资本的60%；陈亚菊出资1,440万元，占捷捷新材料注册资本的24%；郭熹出资720万元，占捷捷新材料注册资本的12%；崔小亮出资240万元，占捷捷新材料注册资本的4%。江苏捷捷半导体新材料有限公司于2020年起纳入合并范围。

2、2020年7月7日，江苏捷捷微电子股份有限公司以自有资金10,000万元人民币在江苏无锡新吴区设立全资子公司“捷捷微电（无锡）科技有限公司”，公司出资比例为100%。捷捷微电（无锡）科技有限公司于2020年起纳入合并范围。

3、2020年9月18日，江苏捷捷微电子股份有限公司以自有资金20,000万元人民币在江苏省南通苏锡通科技产业园设立全资子公司“捷捷微电（南通）科技有限公司”，公司出资比例为100%。2020年12月31日，经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司向全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司增资的议案》，同意以自有资金对捷捷南通科技进行增资，增资金额人民币60,000万元。本次增资后，捷捷南通科技注册资本由20,000万元增加至80,000万元。捷捷微电（南通）科技有限公司于2020年起纳入合并范围。

4、2020年10月16日，江苏捷捷微电子股份有限公司以自有资金10,000万元在江苏省南通中创区设立全资子公司“江苏捷捷半导体技术研究院有限公司”，公司出资比例为100%。江苏捷捷半导体技术研究院有限公司于2020年起纳入合并范围。